公司代码:603936　　公司简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘燕平	黄晓丹
电话	0753-2329896	0753-2329896
传真	0753-2329836	0753-2329836
电子信箱	yp_liu@bominelec.com	xd_huang@bominelec.com

1.6 拟以2015 年末总股本167,350,000 股为基数,按每10股派现金0.5元(含税),共计派发现金股利8,367,500.00元。该预案须提交公司2015年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板。上述产品被广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防和清洁能源等领域,涉及的主要终端产品包括:智能手机、平板电脑、Pos机、家电、汽车多媒体系统、汽车中控系统、网络接入设备、工控机箱或主机、税控机以及数控机床等。

(二)经营模式

1、采购模式公司一般根据订单需求进行采购,原材料采购具有采购频率高、单次采购量小的特点。本公司的主要原材料采取直接向供应商采购的模式,其他品种多、采购量小的辅材主要通过经销商采购。由于市场比较透明,本公司通过选择多个供应商进行资质鉴定或对比,通过供应商开发与选择、供应商导入、供应商评审等环节选择出符合标准的供应商纳入到合格供应商名单中,作为长期合作伙伴。此外,公司针对部分原辅材料如油墨、干膜、钻咀等,采用VMI(供应商管理库存)方式,实现零库存。

2、生产模式公司根据订单生产,此外,在公司产能无法满足客户需求时,公司将部分订单的部分生产环节(如钻孔、压合等)交由其他有资质的企业完成,公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。

3、销售模式公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。

(1)直销模式:公司与主要客户签订"产品框架协议"或"质量保证协议"等,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,并约定产品规格、销售价格和数量等。

(2)经销模式:经销商在获取终端客户订单后,向公司下达相应订单,公司在接到订单并完成生产后,将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端客户。

(三)行业状况印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,也是结合电子、机械、化工材料等众多领域之基础产品,可以说,几乎所有的电子设备都离不开印制电路板,因而被称为"电子系统产品之母",不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。

1、行业特点近年来随着下游电子信息产业、汽车产业等行业发展,各种电子产品需求量大幅上升,进一步拓宽了印制电路板制造产业的发展空间。同时,随着国内居民收入的不断提高,电子产品的日益普及,消费类电子产品需求始终保持着高速增长的态势,使得印制电路板制造产业稳步发展。在此基础上,印制电路板制造企业不仅可以通过持续不断的技术创新、提高产品档次和增加技术附加值来增强市场竞争力,而且可以通过抓紧市场需求方向、改善产品结构和提高市场占有率等办法来提高盈利能力。总之,印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,受单一行业的影响较小。

2、行业的区域性、周期性、季节性特征

(1)周期性特征印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,尤其随着近年来下游行业更趋多元化,已从主要依赖传统电子产品发展到覆盖消费电子、通讯设备、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天和军工产品等社会经济各个领域,受单一行业影响较小,因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动而波动。

(2)区域性特征就全球而言,以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛。作为人口大国,我国目前人均电子消费产品消费水平仍然较低,然而随着我国城市化进程的持续推进,消费升级、需求的多样化将成为未来国内消费的主要特征。综合考量国外电子产品生产商及其研发机构向我国境内转移的现状,未来我国对印制电路板需求的增速将高于全球平均水平。就我国自身而言,由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高,且电子信息产业一直比较发达,上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。

(3)季节性特征印制电路板行业的季节性特征总体不明显,但由于受到节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响,行业内企业下半年的生产和销售规模普遍高于上半年。

3、公司的行业地位经过多年积累和发展,公司已形成了完整的PCB全制程生产能力和合理的产品结构,公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势,始终坚持实施差异化产品竞争战略,形成以HDI板产品为核心的产品体系,且已掌握任意阶HDI产品的生产工艺技术并已开始批量生产。公司2015年底成功在上海证券交易所上市,公司的融资渠道进一步拓宽,随着未来首发募集资金投资项目在江苏博敏的逐步投产,公司将在巩固和扩大HDI板市场占有率的同时,提升挠性电路板、刚挠结合板和任意阶HDI板等高新产品的生产能力,从而进一步加强自身在工艺技术水平和产品结构上的竞争优势,未来占据更大的市场份额。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,785,204,668.61	1,340,040,981.64	33.22	1,215,838,244.26
营业收入	1,130,254,643.17	1,053,667,556.44	7.27	1,001,600,189.47
归属于上市公司股东的净利润	60,958,524.91	69,221,557.05	-11.94	71,125,113.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,031,973.72	58,706,934.31	-25.00	68,383,919.78
归属于上市公司股东的净资产	889,239,423.93	527,830,163.81	68.47	458,608,606.76
经营活动产生的现金流量净额	19,625,451.57	168,136,519.95	-88.33	100,448,145.96
期末总股本	167,350,000.00	125,500,000.00	33.35	125,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.486	0.552	-11.96	0.567
稀释每股收益(元/股)	0.486	0.552	-11.96	0.567
加权平均净资产收益率(%)	10.92	14.03	减少3.11个百分点	16.81

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	214,365,527.84	300,507,631.27	269,659,550.34	345,721,933.72
归属于上市公司股东的净利润	7,935,812.46	24,253,345.75	11,751,473.69	17,017,893.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,185,841.17	17,730,697.35	10,438,123.33	9,677,311.87
经营活动产生的现金流量净额	58,797,806.15	6,582,431.98	-40,928,348.10	-4,826,438.46

五　股本及股东情况

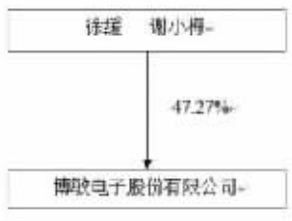
5.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

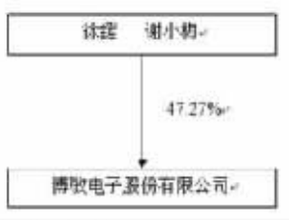
截止报告期末普通股股东总数(户)	34,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,150
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐缓	0	50,833,000	30.38	50,833,000	无	0	境内自然人
谢小梅	0	28,270,000	16.89	28,270,000	无	0	境内自然人
刘燕平	0	16,543,500	9.89	16,543,500	无	0	境内自然人
谢建中	0	15,603,500	9.32	15,603,500	无	0	境内自然人
高建芳	0	5,000,000	2.99	5,000,000	无	0	境内自然人
郑晓辉	0	3,333,333	1.99	3,333,333	无	0	境内自然人
王会民	0	1,666,667	1.00	1,666,667	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.60	0	无	0	其他
吴国栋	855,500	855,500	0.51	0	无	0	境内自然人
黄继茂	0	350,000	0.21	350,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,徐缓与谢小梅系夫妻关系;谢建中与谢小梅系兄妹关系;谢建中与刘燕平系夫妻关系;其中徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人;公司第一、二、三、四股东存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3　公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)						
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况
						股份状态　数量
前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明						

六　管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年PCB行业整体表现低于预期,据Prismark初步估算,2015年全球PCB产值较2014年出现约1.80%的微幅下滑,中国PCB产值较2014年仅微幅增长0.20%。

公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为多层(含HDI)和单/双面印制电路板。公司的产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防及清洁能源等领域。主要客户包括百富计算机、三星电子、格力电器、比亚迪、新大陆电脑、伊顿电气、新国都、华智融和瑞斯康达等国内外知名企业。2015年公司实现营业收入113,025.46万元,比2014年增长了7.27%;归属于上市公司股东的净利润约6,095.85万元,与2014年相比增长了-11.94%;经营活动产生的现金流量净额1,962.55万元,比2014年增长-88.33%。

公司子公司江苏博敏部分厂房、设备在2015年陆续投入生产,受新设备的磨合、试生产、产品产能不饱和以及固定资产折旧等因素影响,江苏博敏未达到盈亏平衡。公司对外积极开拓新客户,并加强与客户的研发合作,提高客户合作深度;对内进一步强化管理,提升良品率,优化产品结构,并以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善。

公司秉承"创新连接、沟通世界"的企业使命,坚持"诚信、责任、创新、进取、优质、人本、共享"的价值观,旨在立足于高精密印制电路板制造产业巨大发展空间的基础上,实施差异化产品竞争战略,尤其是以HDI板、挠性电路板、刚挠结合板以及铝基板、高频基板等特殊板为代表的新一代印制电路行业发展技术为主导方向,最终将公司发展成为最值得信赖的电子电路供应商。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,受宏观经济影响,PCB行业的发展放缓。公司通过积极把握新常态下的市场发展机遇,努力跟紧行业发展新趋势,实现营业收入113,025.46万元,比去年同期增长7.27%;另一方面,公司募投项目实施主体江苏博敏的部分厂房、设备在2015年陆续投入生产,受新设备的磨合、试生产、产品产能不饱和以及固定资产折旧等因素影响,江苏博敏未达到盈亏平衡,导致报告期内归属于上市公司股东的净利润6,095.85万元,比去年同期下滑11.94%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,130,254,643.17	1,053,667,556.44	7.27
营业成本	900,908,011.47	835,392,037.51	7.84
销售费用	31,107,455.65	32,193,734.91	-3.37
管理费用	108,095,343.11	94,333,861.35	14.59
财务费用	17,789,281.16	14,901,120.67	19.38
经营活动产生的现金流量净额	19,625,451.57	168,136,519.95	-88.33
投资活动产生的现金流量净额	-179,819,594.09	-169,926,302.51	-5.82
筹资活动产生的现金流量净额	325,671,712.83	-11,500,031.58	2,931.92
研发支出	54,004,296.64	47,042,616.53	14.80

1.　收入和成本分析

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
印制电路板	1,105,964,314.62	898,325,606.69	18.77	7.49	7.97	减少0.35个百分点
其他	24,290,328.55	2,582,404.78	89.37	-2.11	-22.80	增加2.85个百分点
合计	1,130,254,643.17	900,908,011.47	20.29	7.27	7.84	减少0.42个百分点

2.　费用

期间费用等同比变化情况:

项目	本期金额	上期金额	较上期变动比率%
销售费用	31,107,455.65	32,193,734.91	-3.37
管理费用	108,095,343.11	94,333,861.35	14.59
财务费用	17,789,281.16	14,901,120.67	19.38

3.　研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	54,004,296.64
本期资本化研发投入	?-
研发投入合计	54,004,296.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.78
公司研发人员的数量	632
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.63
研发投入资本化的比重(%)	

4.　现金流

现金流等同比变化情况:

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,625,451.57	168,136,519.95	-88.33
投资活动产生的现金流量净额	-179,819,594.09	-169,926,302.51	-5.82
筹资活动产生的现金流量净额	325,671,712.83	-11,500,031.58	2931.92

情况说明

筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司上市吸收投资收到的现金增加。

(二)　资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	287,348,935.94	16.10	100,376,087.78	7.49	186.27	公司12月公开发行A股,募集资金到位所致。
应收票据	45,626,412.13	2.56	7,435,327.92	0.55	513.64	期末现金充裕,票据贴现及背书减少所致。
应收账款	334,629,657.09	18.74	228,648,082.39	17.06	46.35	主要是延长优质客户信用期限
其他流动资产	38,647,570.32	2.16	23,574,822.03	1.76	63.94	主要是购进银行理财产品增加
长期待摊费用	3,028,781.28	0.17	2,181,492.81	0.16	38.84	车间改造增加
其他非流动资产	44,725,074.41	2.51	18,997,393.74	1.42	135.43	预付工程设备款增加
一年内到期的非流动负债	31,308,978.07	3.49	9,543,056.72	1.17	228.08	主要是一年内到期的融资租赁款增加
长期借款	57,360,000.00	6.40	42,000,000.00	5.17	36.57	子公司固定资产投资需要,银行长期借款增加
长期应付款	23,105,377.98	2.58	9,431,654.28	1.16	144.98	增加了设备融资租赁

(三)　行业经营性信息分析

1、国内印制电路板产业区域结构总体特征

我国印制电路板制造企业主要集中在华南地区和华东地区,同时华南与华东地区企业的资产规模和销售收入在整个行业也占有绝对优势。

未来,我国印制电路板产业很可能形成以珠三角、长三角作为高端PCB制造和设备、材料的研发、物流总部基地;以长江沿岸的包括重庆、四川、湖北、安徽和江西等有世界五百强电子企业为龙头的二小时经济产业带;以北方大连为龙头的环渤海湾经济圈;以及港珠澳大桥通车后的粤西北加工区。

2、国内印制电路板主要产品结构及未来发展趋势

根据CPCA统计,2000年以来国内各类PCB产品都得到明显的发展,其中多层板、HDI板和挠性电路板发展速度高于行业平均发展速度,单/双面板发展速度相对稳定。

近年来,智能终端和触控产品的发展带动了HDI板的发展,以iPhone、三星手机、iPad平板电脑和超级本等为代表的消费电子产品进一步走向小型化、高精密化和多功能化使得高阶HDI设计及应用成为这些产品的主流。此外,我国PCB产品结构中的另一亮点为挠性电路板的发展。随着智能手机、数码相机、高清电视(HD-TV)和其他数据处理产品中FPC的应用越来越广泛,挠性电路板产品在近年持续保持较快增长。

展望未来,随着下游电子系统产品更新换代,HDI板及挠性电路板用量扩大这一趋势将保持延续。

3、印制电路板行业利润特点及上下游情况

印制电路板制造行业的主要原材料为覆铜板、铜箔、铜球、半固化片、油墨和干膜等,上述原材料的供应情况和价格水平决定了印制电路板企业的生产成本。印制电路板制造行业的主要下游应用领域为消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、清洁能源、智能安防、航空航天及军工产品等,上述行业的周期性波动决定了印制电路板产品的需求和价格水平。

印制电路板制造企业的利润水平主要取决于上下游的变动情况。一般而言,技术水平较低、生产规模较小的企业如单/双面板生产企业由于技术壁垒相对较小,价格竞争激烈,对成本转嫁的能力相对较弱;而具有工艺技术优势和规模优势的企业则转嫁成本能力较强,尤其以HDI板、挠性电路板、刚挠结合板和特殊基材板等高端产品生产企业明显,由于其资金投入较大、技术门槛较高,一定程度上限制了新进入者的数量和进入速度,产品毛利率相对较高。

随着移动终端等产品需求的增长,未来面向消费电子类的印制电路板产品特别是高精密度和特殊材质基板的需求将呈增长的态势。目前,电子产品具有两大发展趋势,一个是消费者对于电子产品超薄便携的要求,为HDI板、挠性电路板和刚挠结合板的发展提供了机遇;另一个是电路高频高速下的稳定性要求和环境保护的要求,由于当前电路传输速度快、信息处理量大,对于印制电路板的可靠性要求很高,且受绿色环保概念在电子产业中的持续推广,未来对于高端特殊基板(如高频板、铝基板、厚铜板等)的需求将持续上升。

(四)　投资状况分析

报告期内,公司向控股子公司江苏博敏增资21,045.07万元,增资来源为公司本次首次公开发行股票所募集资金;其中计入江苏博敏注册资本2,000万元,计入资本公积19,045.07万元;本次增资完成后,江苏博敏注册资本变更为12,000万元,资本公积19,045.07万元,注册资本和资本公积合计为31,045.07万元。

(五)　主要控股参股公司分析

深圳市博敏电子有限公司成立于1994年5月24日,注册资本3,300万元,为公司的全资子公司,经营范围:数控加工设备及自动检测设备配套应用软件,计算机软、硬件及应用系统的开发,仪器仪表,电子产品的销售,国内商业、物资供销业(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目);生产、加工印刷线路板。经营进出口业务(按深贸管登证字第2002-246号文办)。截至2015年12月31日,该公司资产总额为32,342.70万元,净资产为12,614.62万元,2015年实现净利润819.90万元。

江苏博敏电子有限公司成立于2011年6月8日,注册资本12,000万元,为公司的全资子公司,经营范围:高端印制电路板(高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC)、新型电子元器件、传感器、物联网RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至2015年12月31日,该公司资产总额为56,861.25万元,净资产为27,764.50万元,2015年实现净利润-2,003.41万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)　行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

从国际市场来看,近年来亚洲地区的印制电路板生产能力增长较快,主要系亚洲地区拥有丰富廉价的劳动力资源、中国大陆的下游制造业快速发展和欧美发达国家印制电路板制造企业向亚洲整体转移所致。从产品结构来看,低端印制电路板(单/双面板)由于进入壁垒相对较低,竞争已比较充分,供需基本保持了较平衡的状态。其次,高端印制电路板(HDI板、挠性电路板、刚挠结合板和其他特殊材质印制板等)由于对技术、设备和工艺等要求较高,且具有进入壁垒高、扩产周期长等特点,在下游智能电子消费品及IT产业快速发展的影响下,市场需求上升。

从国内市场来看,我国人口基数庞大,目前人均电子产品消费水平与欧美等发达国家或地区相比仍然较低,然而随着我国城市化进程的持续推进,消费升级、需求的多样化将成为未来国内消费的主要特征。此外,综合考量国外电子产品生产商及其研发机构向我国境内转移的现状,未来我国对印制电路板需求的增速将高于全球平均水平,成为需求增长最强劲的地区。

2、技术发展特点

目前,单面板、双面板技术相对成熟,市场需求规模将在未来较长时期内持续稳定;多层板、HDI板和挠性电路板主要应用在当前产品技术升级换代较快的消费电子领域(如高端智能手机、平板电脑等),正处在成长期;铝基板、高频板、光电板、封装基板等特殊板正在技术先进国家推广和应用,我国正处于产品导入时期。

HDI技术是伴随着电子产品朝着微型化、轻便化、多功能、高集成、高可靠方向发展应运而生的,采用此技术可对印制电路板进行更高密度的布线,目前全球智能电子产品领域的代表性产品iPhone系列手机和iPad系列平板电脑皆为采用HDI板作为其电子元器件之载体,并已通过实践证明与传统手机和电脑产品相比,其功能更加丰富且携带更加轻便。

总体而言,随着世界各国大型印制电路板制造厂商在我国投资建厂,国内印制电路板的技术水平日益提高。当前,以导通孔微小化、导线精细化、积层多层板和集成组件板为主导的新一代印制电路板产品正逐渐发展并走向成熟,该等新技术、新工艺将推动印制电路板产品向高密度化、集成组件的方向发展。此外,目前全球兴起了生态产业发展趋势,打造绿色环保概念产品在电子产业中已经成为共识。全球印制电路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更加严格和迫切,印制电路板制造厂商将会把致力投入开发各类环保型产品作为主要发展方向。

(二)　公司发展战略

1、公司整体发展战略

公司秉承"创新连接、沟通世界"的企业使命,坚持"诚信、责任、创新、进取、优质、人本、共享"的价值观,旨在立足于高精密印制电路板制造产业巨大发展空间的基础上,实施差异化产品竞争战略,尤其是以HDI板、挠性电路板、刚挠结合板以及铝基板、高频基板等特殊板为代表的新一代印制电路行业发展技术为主导方向,最终将公司发展成为最值得信赖的电子电路供应商。

公司将以技术营销为引导,产业孵化为基础,始于客户需求,终于客户满意,提供优质、快捷的产品和服务,力争成为产业链中核心的"价值创造者"。具体而言,公司将在巩固和扩大HDI板市场占有率的同时,积极增强其他诸如挠性电路板、刚挠结合板和特殊基板等新兴产品的生产能力、技术研发水平和营销开拓力度;同时充分利用资本市场的直接融资功能,更好的服务于公司的战略发展规划,为实现公司的跨越式发展奠定坚实的资本基础。

2、整体经营目标

公司将始终专注于高精密印制电路板制造的主营业务,在开展主营业务的产能扩张,突破公司的产能瓶颈的同时,实施积极的市场推广措施,以配合公司未来新增产能的消化,最终实现公司的跨越式发展。

具体而言,公司扩大HDI板产品的生产规模,使公司在能够更好的满足日益增长的智能化电子信息产品终端需求的同时,进一步扩大公司在HDI板应用领域中的市场占有率。报告期内,公司产品结构逐步优化,符合公司长远发展的战略布局,目前公司已掌握任意阶HDI产品的生产工艺技术并已开始批量生产,公司通过首发募投项目的实施扩大公司任意阶HDI板产品的生产能力,并在国内印制电路板制造行业的高端产品市场中继续保持竞争力。另外,作为公司差异化产品竞争战略的重要组成部分,刚挠结合板产品产能的适度扩张将使公司产品更具多元化,提升公司的综合技术生产能力,以满足下游不同应用领域的市场需求,从而提升公司的综合竞争力。

此外,公司将继续加强同国内各大专业院校、科研院所的技术合作,不断加大研发投入,储备多种具有完全自主知识产权和高科技含量的产品,以满足下游客户快速增长的各类个性化需求。

(三)　经营计划

1、加快募集资金项目建设和运营效率

(1)加快江苏博敏高端HDI生产建设。截至2015年底江苏博敏部分生产线建设完成并投入生产,2016年公司将在原有基础上按计划继续加快对江苏博敏高端　HDI生产线进行投入,以达到原规划设计并能。

(2)加大对应产品市场开发力度。2016年将集中公司市场资源全力以赴开发高端HDI市场客户,满足江苏博敏不断扩大的产能。以尽早实现江苏博敏扭亏为盈。

(3)加强对江苏博敏的日常管理监控,尤其加大对江苏博敏预算控制和绩效管理。加强相关工作检查监督,充分调配好现有资源,促进项目高效运行,保证募投项目有序高效发挥作用。

2、产品开发计划

公司坚持以市场为导向,紧跟行业下游领域产品的更新变化趋势,不断开发生产适应市场需求的产品,扩大绿色环保、替代进口等高新技术印制电路板产品所占比重,逐步形成以HDI板产品为核心的多元化、可持续发展的产品研发体系。

公司将在持续提升现有主导产品的技术水平和生产能力的基础上,不断加大对高端产品的研制和开发。具体计划如下:

(1)提升HDI板生产能力和工艺技术水平

随着下游行业的快速发展,电子信息产品更新换代的速度加快,技术更新也日新月异,高端印制电路板的市场需求旺盛。公司现有HDI板生产线的产能已不能满足行业发展趋势及市场需求,为进一步增强公司竞争力,提升市场占有率,公司通过首发募投项目的实施将新建36万平方米/年HDI板生产线和24万平方米/年任意阶HDI板生产线。

在工艺技术方面,公司计划未来将HDI板最小线宽线距达到0.03mm,最小机械孔径达到0.1mm,最小激光孔径达到0.05mm,最小厚度达到0.2mm。

(2)提升挠性电路板和刚挠结合板生产能力和工艺技术水平

为进一步提升公司FPC产品产能,增强公司综合竞争力,公司通过首发募投项目的实施将新建8万平方米/年刚挠结合板生产线,以提高FPC产品市场占有率。

工艺技术方面,公司计划未来将挠性电路板最高层数达到12层,最小线宽线距达到0.025mm,最小机械孔径达到0.1mm,最小激光孔径达到0.05mm;将刚挠结合板最高层数达到20层,最小线宽线距0.025mm,最小机械孔径0.1mm,最小激光盲孔0.05mm。

3、人力资源计划

公司一贯视人才为企业发展的第一要素,为实现公司的发展战略,公司将通过内部培养和外部引进相结合的方式,提高人才素质、完善人才结构。为使公司的人力资源配置满足公司发展需要,公司已制定并坚决执行以下措施:

(1)适量招收各相关专业的高校毕业生,改善人才结构;

(2)加强对现有员工的教育和培训,优化人力资源配置;

(3)加大对高级管理、专业技术人才和销售人才的引进力度,使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍;

(4)进一步完善各类岗位人员,特别是关键管理岗位、技术岗位和销售人员的薪酬体系和激励机制,合理确定薪酬结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务;

(5)继续改善公司的工作生活环境,增强员工对企业的认同感和满意度。

4、技术开发与创新计划

为更好适应市场变化并确保公司的可持续发展,公司制定了详细的技术开发和创新计划。在技术创新方面,一是确立以企业为主体的技术创新模式。公司以市场竞争为导向,并据此确立研发方向,赋予研发明确的策略性,直接与企业营运融合,与业务密切结合,同时加强研发战略的职能作用。研发在配合业务的同时,也注重"专业性发展和横向联合",使企业的研发活动逐渐主动化,并积极寻找新的市场行业机会,争取价值链主导地位。二是不断加强与国内各大专业院校、科研院所的广泛合作,走强强联手之路。

5、市场开发与营销计划

公司坚持以技术营销为引导,产业孵化为基础,始于客户需求,终于客户满意,提供优质、快捷的产品和服务,成为核心的"价值创造者"。面对信息时代的"价值追求者",传统意义上的满足客户需求,已无法从根本上解决问题,只有立足于客户价值这一中心,帮助客户实现其价值追求,企业才能有效地迎合客户千差万别的需求,最终求得企业自身的发展。因此,公司着重通过以下渠道开发和拓展市场:

(1)进一步加大销售队伍、销售体系的建设,开拓新客户;

(2)提高对现有客户的合作深度,提升现有产品市场份额。

可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,几乎所有的电子设备都离不开印制电路板,因此,印制电路板行业的景气程度与电子信息产业的整体发展状况、宏观经济的运行情况密不可分。尤其是近年来,我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地,我国印制电路板行业受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。

具体而言,2010年,全球经济自2008年金融危机以来开始出现复苏迹象,中国PCB行业恢复增长,产值达200亿美元。2011年,受惠于智能手机、平板电脑、超级本、触控屏以及汽车电子等下游产业的带动,中国PCB行业产值增长至220亿美元,占全球PCB总产值的39.71%。2012年,受欧美经济持续疲软、全球经济恢复低于预期的影响,全球PCB产值较上年下滑2.0%,全球各主要PCB生产地区年产值均出现不同程度的下降,其中欧洲、美洲、日本和中国的PCB产值降幅分别达到-8.2%、-6.0%、-6.3%和-1.8%。

若全球经济未来出现剧烈波动,PCB行业的发展速度放缓或出现下滑,公司存在主营业务收入及净利润下滑的风险。

2、市场竞争的风险

鉴于PCB行业各类生产企业众多,未出现市场主导者,行业的市场集中度较低,PCB生产企业的市场竞争激烈。同时,伴随着下游产业终端电子产品竞争加剧、价格持续走低,对应PCB产品也可能存在价格下降风险。鉴于PCB生产企业的激烈市场竞争和PCB产品价格下降的风险,若公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行技术和业务模式创新以提高公司竞争实力,及时推出有竞争力的高技术高附加值产品,则公司存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

3、原材料价格波动的风险

公司日常生产中主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、金盐、干膜、半固化片和油墨等。覆铜板、铜箔、铜球和金盐价格主要受国际大宗商品金属价格的影响。报告期内,受全球经济波动等因素影响,国际铜价和金价在出现持续下降后呈现触底回暖趋势。

原材料采购价格的变化是导致公司毛利率波动的重要因素。如果未来原材料的价格出现大幅上涨,而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力,将会对本公司的经营成果产生不利影响。

4、环保相关的风险

公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声,特别是PCB生产中包含电镀工序,环保要求较高,如果处理不当会污染环境,给人民生活带来不良影响。

公司自成立以来建立了系统的污染物处理管理制度和设备体系,对每一项新建或技改项目都要经过严密论证,使公司的"三废"排放达到了环保规定的标准。但公司仍不能完全排除在生产过程中因管理疏忽等原因或不可抗力等因素出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规,则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。

同时,随着社会对环境保护意识的不断增强,我国对环保方面的要求日趋提高,在我国总体环境压力增加的前提下,国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规,提高环保标准,并不断提高对企业生产经营过程的环保要求,这都将导致公司的环保成本增加,从而对盈利水平带来一定影响。

5、规模扩张引发的管理风险

随着公司业务经营规模的不断扩大,尤其是首发募集资金投资项目的陆续投产,公司的产销规模将快速扩张,同时,PCB生产技术含量越来越高、工艺流程日趋复杂,如果公司未来不能在管理方式上及时创新,以适应公司规模快速扩张的需要,可能会出现交货期延长、竞争力削弱、成本上升等风险。随着公司经营规模的扩张,对公司组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求,如何建立更加有效的投资决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题,将对公司生产经营造成不利影响,制约公司的发展。

6、所得税优惠政策变化的风险

公司于2010年9月被认定为高新技术企业,并于2013年12月3日获发复审通过后的高新技术企业证书。公司于2010年度至2015年度享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

公司子公司深圳博敏、江苏博敏均被认定为高新技术企业,且取得高新技术企业证书,尚在有效期内。

若未来公司或深圳博敏、江苏博敏到期后不能通过高新技术企业资格认定,致使相关所得税税收优惠政策发生重大不利变化,将对公司未来经营业绩产生一定影响。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更